

# 板级 底部填充胶



为了在现代电子组装应用中确保卓越的机械稳定性和长期的可靠性，底部填充胶在倒装芯片和BGA组装应用中至关重要。底部填充胶能够减少组件的机械应力，提高热性能，确保温度敏感类电子产品的耐用性。

Hoenle的先进配方采用精细填料，有效降低底部填充胶的热膨胀系数（CTE），提高其在应用中的可靠性。环氧基底部填充胶具有优异的毛细管流动性，即使在复杂的结构设计中，也能很好的实现窄间隙的完全填充。

Hoenle高品质的底部填充胶具有加热快速热固化和优秀的流淌性能，不仅可以有效的提高UPH和节约能效，而且可以有效的提升元器件的机械强度、热稳定性和使用寿命。广泛应用于消费电子、汽车电子、5G通信和电源模块等领域。

## 主要优势

- 有效缓解机械应力
- 显著提高热稳定性
- 确保完全填充芯片与基板的间隙
- 对于不同结构应用均可保持优异的流淌性
- Structalit®8202系列可实现持续的元器件返修与再加工



提高焊点的耐热可靠性



缓冲对于元器件的机械应力



优异的可返修性

# 底部填充胶 创新点

## STRUCTALIT® 8202

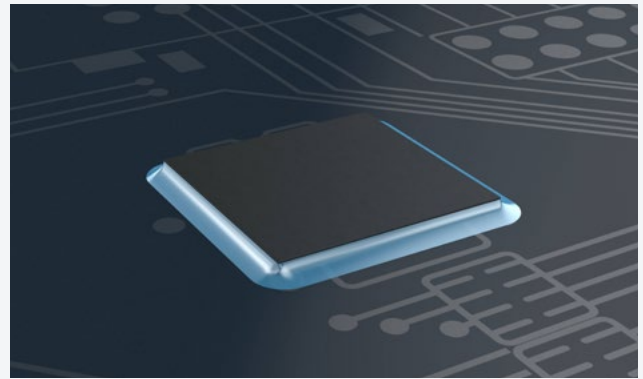
- 黑色环氧
- 无填料，优异的毛细流淌性能
- 低介电常数
- 可返修
- 与大部分无铅锡膏类材料兼容
- 在冷热循环中为保护焊点提供优异的机械性能

## STRUCTALIT® 8205

- 黑色环氧
- 高温 (80-110°C) 下优异的流淌性
- 低热膨胀系数
- 点胶时容易控制溢胶距离 (KOZ < 300µm)
- 在冷热循环中为保护焊点提供优异的机械性能
- 高可靠性，可以通过3次回流焊测试

## STRUCTALIT® 8202 A

- 透明琥珀色环氧
- 无填料，优异的毛细流淌性能，特别推荐用于窄填充间隙 (< 20µm)
- 低介电常数，可返修
- 与大部分无铅锡膏类材料兼容
- 在冷热循环中为保护焊点提供优异的机械性能



胶粘剂型号	粘度 (cps)	固化方式	硬度 (邵氏)	玻璃化转变温度 (°C)	热膨胀系数 (CTE)	断裂延伸率 (%)	杨氏模量 (MPa)
Structalite® 8202	300-400	10 min@130°C	D 65-85	85-100	30-60/ 160-300	<5	2,000-3,000
Structalite® 8202 A	250-400	10 min@130°C	D 65-80	90-100	50-70/ 160-220	<5	2,000-3,000
Structalite® 8205	6,000	15 min@130°C	D 90	130	31/79	0.5	8,000

好乐紫外技术贸易 (上海) 有限公司  
上海浦东新区商城路800号  
斯米克大厦821-822室  
200120 上海 中国



有关区域销售和技术支持，请参阅我们的全球官方网站  
[www.hoenle.cn/contact](http://www.hoenle.cn/contact) 或通过微信公众号联系

电话: +86 21 64 73 02 00  
邮箱: [info@hoenle.cn](mailto:info@hoenle.cn)

参数取决于生产特性，可能与上述信息不同。我们保留修改技术数据的权利。

©版权所有 Hoenle Adhesives GmbH。更新日期12/25